

『高周波デバイス検査用ソケット』標準化
量産体制構築

株式会社ヨコオ
東京都北区滝野川7-5-11
TEL:03-3916-3111(代表)

■要旨

当社は、高周波デバイス検査市場をターゲットとした「高周波デバイス検査用ソケット（ハイギガコンタクトユニット）」の設計、仕様を標準化し、今後の需要増に対応できる量産体制を構築しました。

■市場動向

半導体業界では、パソコン・ゲーム機・通信機器などの高性能化および高機能化に伴う情報処理量の増大に対処するため、演算速度の向上およびそれに対応した数Gbps～10Gbpsのインターフェースを備えたデバイスの開発が進んでいます。そして半導体検査市場では、このようなデバイスを検査するための高周波デバイス検査用ソケット需要がますます拡大しています。

■標準化への経緯

当社では以前より高周波デバイス検査用ソケットを製造・販売していますが、当ソケットは顧客仕様により一品一様であるため、受注の都度、設計、材料手配、部品加工が必要であり、顧客要求への十分な対応は困難でした。

一方、需要の増加とともに、納期短縮、コストダウンの要求が強まってきており、当社では今般、こうした要求に対応するため、当ソケットに使用されるプローブピンや、金属製ハウジング、絶縁材料などの設計、仕様を標準化することにより、製造日数を大幅短縮および量産への対応を可能としました。

【納期】＝ 従来品：1.5ヶ月 → 標準品：約3週間

■「高周波デバイス検査用ソケット」の特長

1) 性能、価格により「樹脂挟みタイプ」と「インシュレータリングタイプ」の2タイプ。

①樹脂挟みタイプ

- ・周波数範囲：DC～6GHz
- ・対応ピッチ：0.5mm/0.8mm
- ・最大ピン数：144ピン

②インシュレータリングタイプ

- ・周波数範囲：DC～10GHz
- ・対応ピッチ：1.0mm
- ・最大ピン数：1600ピン

- 2) プローブ方式のため、当社従来品ソケットと互換性がある
- 3) 従来ソケットと比較し、挿入損失、反射損失、クロストーク特性に優れている
- 4) 板バネおよびシートタイプに比べ、安定したコンタクトが得られる
- 5) ユーザーにて、信号、電源、GNDピンの入れ替え可能である
- 6) ESD対策がされている

■今後の計画

今回の標準化を機に、当社は国内および海外において「高周波デバイス検査用ソケット」の積極的な拡販活動を行い、2005年は年間500台の販売を目指しています。

★本件に関するお問い合わせ先
コネクタカンパニー
回路検査用コネクタ事業部

TEL : 03-3916-3116

以 上